

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-121

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 关于调整公司向特定对象发行股票

### 募集资金使用可行性分析报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等关于本次向特定对象发行股票的相关议案。

根据公司业务发展和未来规划，公司拟对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行调整，具体如下：

#### 一、调整情况

##### （一）调整前

##### “一、本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 30,121.00 万元（含 30,121.00 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产光伏焊带 3 万吨项目	28,744.00	21,121.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		37,744.00	30,121.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项

目的进度、资金需求等实际情况,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

.....

## 5、项目投资估算

项目投资总额为 28,744.00 万元,包含土地投资 1,376.00 万元,建设投资 10,350.00 万元,设备投资 13,048.00 万元,软件投资 400.00 万元,预备费 1,259.00 万元,铺底流动资金 2,311.00 万元。

本项目的投资估算情况如下:

单位:万元

序号	项目	金额	占总投资比例 (%)	拟使用募集资金金额
1	土地投资	1,376.00	4.79%	-
2	建设投资	10,350.00	36.01%	7,673.00
3	设备投资	13,048.00	45.39%	13,048.00
4	软件投资	400.00	1.39%	400.00
5	预备费	1,259.00	4.38%	-
6	铺底流动资金	2,311.00	8.04%	-
	合计	<b>28,744.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,121.00</b>

本项目总投资 28,744.00 万元,拟使用募集资金 21,121.00 万元,不包括项目总投资中的预备费和铺底流动资金,不包括董事会前投入的资金。”

### (二) 调整后

#### “一、本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 30,121.00 万元(含 30,121.00 万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产光伏焊带 3 万吨项目	28,744.00	10,500.00
2	补充流动资金	9,000.00	4,500.00
	合计	<b>37,744.00</b>	<b>15,000.00</b>

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权主体可根据项

目的进度、资金需求等实际情况,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

.....

### 5、项目投资估算

项目投资总额为 28,744.00 万元,包含土地投资 1,376.00 万元,建设投资 10,350.00 万元,设备投资 13,048.00 万元,软件投资 400.00 万元,预备费 1,259.00 万元,铺底流动资金 2,311.00 万元。

本项目的投资估算情况如下:

单位: 万元

序号	项目	金额	占总投资比例 (%)	拟使用募集资金金额
1	土地投资	1,376.00	4.79%	-
2	建设投资	10,350.00	36.01%	4,000.00
3	设备投资	13,048.00	45.39%	6,500.00
4	软件投资	400.00	1.39%	-
5	预备费	1,259.00	4.38%	-
6	铺底流动资金	2,311.00	8.04%	-
	合计	<b>28,744.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,500.00</b>

本项目总投资 28,744.00 万元,拟使用募集资金 10,500.00 万元,不包括项目总投资中的预备费和铺底流动资金,不包括董事会前投入的资金。”

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日